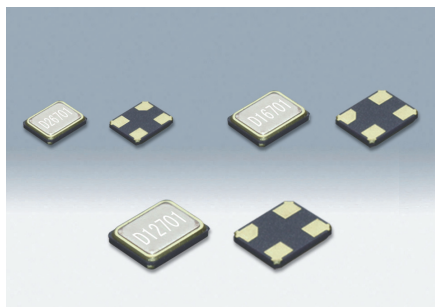


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器(汽车电子用)

DSX211SH/DSX221SH/DSX321SH



实际尺寸 DSX211SH □ DSX221SH □
DSX321SH □

■ 优点

- 小型·薄型·SMD晶体谐振器 DSX211SH: 2016尺寸、厚度0.45mm
DSX221SH: 2520尺寸、厚度0.45mm
DSX321SH: 3225尺寸、厚度0.65mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性
- 支持广泛的频率 DSX211SH: 24~50MHz
DSX221SH: 12~54MHz
DSX321SH: 12~50MHz
- 无需防湿包装管理 Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
- 依据AEC-Q200



■ 用途

- Bluetooth、无线局域网、GPS/GNSS等车载无线、多媒体设备、车载摄像头等

■ 一般规格

项目	型号	DSX211SH		DSX221SH			DSX321SH			
		频率范围	谐波次数	负载电容	激励电平	频率公差	串联电阻	频率温度特性	保存温度范围	可靠性规格
频率范围		24~30MHz	30~50MHz	12~16MHz	16~24MHz	24~30MHz	30~54MHz	12~20MHz	20~28MHz	28~50MHz
谐波次数		Fundamental								
负载电容		8pF, 10pF, 12pF								
激励电平		10μW (100μW max.)		10μW (200μW max.)						
频率公差		±30 × 10 ⁻⁶ (at 25°C)								
串联电阻		150Ω max.	100Ω max.	250Ω max.	200Ω max.	150Ω max.	100Ω max.	120Ω max.	100Ω max.	80Ω max.
频率温度特性		±100 × 10 ⁻⁶ / -40~+125°C (Ref. to 25°C)								
保存温度范围		-40~+150°C								
可靠性规格		AEC-Q200								
包装单位		3000pcs./reel(φ180)								

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DSX211SH

■ DSX221SH

■ DSX321SH

■ [mm]

■ 外形尺寸

2.05±0.1
1.65±0.1
0.45±0.05
1.275
0.975
0.575
0.475

■ 内部连接

(Top View)

#1, #3为晶体端子
#2, #4与防护罩连接
#2, #4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

1.4
1.1
0.9

■ 外形尺寸

2.5±0.15
2.0±0.15
0.45±0.05
1.6
1.25
0.7
0.55

■ 内部连接

(Top View)

#1, #3为晶体端子
#2, #4与防护罩连接
#2, #4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

1.75
1.3
1.15
1.0

■ 外形尺寸

3.2±0.1
2.5±0.1
0.65±0.1
2.1
1.5
0.9
0.8

■ 内部连接

(Top View)

#1, #3为晶体端子
#2, #4与防护罩连接
#2, #4推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

2.2
1.7
1.4
1.2